

## ROMPOX<sup>®</sup> 1106 ESD-Kupferband

**Elektrisch leitendes Kupferband zur Ableitung von elektrostatischen Strömen bei allen antistatischen und ableitfähigen Beschichtungs- und Versiegelungssystemen der ROMEX<sup>®</sup>**

### Anwendungsgebiete:

ROMPOX<sup>®</sup> 1106 ESD-Kupferband ist eine einseitig selbstklebende Kupferfolie aus Reinelektrolytkupfer, elektrisch leitend, mit einer guten Klebekraft auf glatten Oberflächen und daher für alle antistatischen und ableitfähigen ROMEX<sup>®</sup> Beschichtungs- und Versiegelungssystemen besonders gut geeignet.

### 1. Technische Daten der flüssigen Komponenten

#### 1.1 Technische Daten:

Träger:	<b>Folie aus Reinelektrolytkupfer</b>	
Klebstoff:	<b>Acrylatklebstoff</b>	
Dicke / Breite:	<b>0,035 / 10 mm</b>	
Schutzabdeckung:	<b>silikonisierte Folie</b>	
Reinheit:	<b>Elektrolyt-Kupfer</b>	
Elektrische Leitfähigkeit nach IPC 4562:	<b>&lt;0,162 <math>\Omega</math> x g/m<sup>2</sup></b>	
Schälfestigkeit +20°C:	<b>20 N/25 mm</b>	Afera Norm 4012
Scherfestigkeit +20°C:	<b>20 N/6,25 cm<sup>2</sup></b>	Afera Norm 4012
Temperaturbeständigkeit:	<b>-30°C bis +90°C</b>	

#### 1.2 Lieferform:

30 Rollen zu 20 m im Karton

#### 1.3 Lagerung:

Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18°C Lagertemperatur.

### 2. Technische Daten bei der Verarbeitung

#### 2.1 Anforderungen an den Untergrund vor der Verarbeitung:

Der Untergrund muss eben, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Lose Teile und sonstige Verschmutzungen müssen entfernt werden. In der Regel ist der jeweilige Untergrund durch Kugelstrahlen vorzubereiten und mit einer Grundierung zu versehen.

#### 2.2 Technische Daten bei der Verarbeitung:

Mindesttemperatur: **+10 °C** (Boden- und Raumtemperatur)

**Bitte beachten:** Die unter Pos. 2.2 angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und variieren bei alternativen Umgebungsbedingungen.

#### 2.3 Verarbeitungshinweise:

Aufkleben von ROMPOX<sup>®</sup> 1106 ESD-Kupferband auf die Grundierung. Pro 400 m<sup>2</sup> Fläche sind an den 4 Flächenecken Kupferbänder (20 cm jeweils am Boden und 20 cm jeweils an der Wand) aufzukleben. Die Verbindungen zwischen den Kupferbändern und der elektrischen Erdungsleitung des Gebäudes sind von einer Elektro-Fachfirma herzustellen. Diese sind gegen mechanische Beschädigung zu schützen.

## Seite 2 zum Datenblatt ROMPOX® 1106 – ESD-Kupferband

### 2.4 Anwendungsbeispiele:

Arbeitsgang	ROMEX® Produkt	Verbrauch	Applikation
<b>ESD-Beschichtung 1,5 mm</b>			
.1 Untergrund- vorbehandlung			Siehe Pos. 2.1
.2 Grundierung	<b>ROMPOX® 1506</b> Mörtelharz	<b>mind. 2x 0,3 kg/m<sup>2</sup></b>	Flutend mit Gummischieber aufziehen und nachrollen
eventuelle Abstreung der 2ten Lage * (Eventualposition) Kratzspachtelung	Feuergetrockneter Quarzsand mit Ø 0,3-0,8 mm je 1mm Schichtdicke 1 GT ROMPOX® 1506 1 GT feuergetrockneter Quarzsand Ø 0,1-0,3 mm	ca. 1,0 kg/m  mind. 0,8 kg/m <sup>2</sup> mind. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	Abstreuen  Mit einlippigen Hartgummischieber oder Glättkelle spachteln, scharf abziehen
eventuelle Abstreung *	Feuergetrockneter Quarzsand mit Ø 0,3-0,8 mm	ca. 0,5 kg/m	Abstreuen
.3 Leitbänder	<b>ROMPOX® 1106</b> ESD-Kupferband	<b>ca. 0,002 lfm/m<sup>2</sup></b>	Schutzstreifen abziehen und mit leichten Druck aufkleben
.4 Leitschicht	<b>ROMPOX® 1104</b> Leitlack	<b>ca. 0,200 kg/m<sup>2</sup></b>	Fellroller im Kreuzgang aufrollen
.5 Beschichtung	<b>ROMPOX® 1107</b> ESD-Beschichtung	<b>mind. 2,4 kg/m<sup>2</sup></b>	Siehe Datenblatt ROMPOX 1107

\* **Hinweis:** Bei Arbeiten in Innenräumen sollte auf die Abstreung der 2ten Grundierung und Kratzspachtelung verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass die weiteren Arbeiten spätestens nach 24 Stunden ausgeführt werden.

Die technischen Datenblätter der ROMEX®-Beschichtungen und Versiegelungen sind zu beachten.

#### BEMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, basieren auf unserer Erfahrung und entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es müssen die Verarbeitung und die Materialmengen auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Hierzu sollte eine Probefläche erstellt werden.

(Ausgabe 2012-02-13) lb, ho  
TD\_DE\_ROMPOX 1106\_Leitband\_12-02-13\_Rev04